

Værktøjslærelære

Plademateriale

Pladeforarbejdning

Pladeforarbejdningsprocesserne kan groft opdeles i to hovedgrupper, Pladebearbejdning og pladefromgivning. Pladebearbejdningsprocesserne omfatter de processer, som resulterer i kontrollerede brud i pladematerialet, det vil sige processer som snitning og lokning, medens, pladeformgivningsprocesserne omfatter de processer, hvor brud i pladematerialet er uønsket, det vil sige processer som dybtrækning og bukning.

Den stigende udnyttelse af metalpladers formgivningsmuligheder har medført et stadigt stigende behov for at kunne vælge de rette materialer og at kunne specificere disses egenskaber.

Til dette anvendes materialeprøvningsmetoder. Disse kan opdeles i to hovedtyper, simulative tests og materialetest.

Pladenormer anvendes til at foreskrive, hvilke kvalitetskrav det leverede plademateriale skal opfylde. I DK er især tyske DIN normer anvendt ved bestilling af plademateriale, men disse afløses efterhånden af EN normer.